



平成19年7月27日

各位

社 名 三菱マテリアル株式会社
代表者名 取締役社長 井手 明彦
(コード番号 5711 東・大証第1部)
問合せ先 広報・IR 室副室長 鈴木 徹
(TEL. 03-5252-5206)

金線事業統合に係る吸収分割契約締結のお知らせ

当社は、平成19年5月25日に発表いたしましたとおり、当社と田中貴金属工業株式会社及び同社子会社である田中電子工業株式会社（以下、「田中電子工業」という）の半導体ボンディング用金線事業（以下、「金線事業」という）の全面統合について、当社の金線事業部門を田中電子工業に承継させる吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社は、昨年、当社の金線事業における子会社であるMMCエレクトロニクス杭州社（中国名：杭州菱慶高新材料有限公司）を、田中電子工業及び同じく田中貴金属工業株式会社の子会社である田中貴金属インターナショナル株式会社との合併会社とし、中国における金線事業の拡大を図ってまいりました。

このような中、当社及び田中貴金属グループは、両社の金線事業の一層の競争力強化を図るため、両グループの金線事業を全面的に統合することで、本年5月に基本合意しておりましたが、技術面の融合、拠点集約及び販売窓口の一本化による効率化のため、当社の金線事業を会社分割し、田中電子工業に承継させることとしたものであります。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割契約承認取締役会	平成19年7月27日
分割契約締結	平成19年7月27日
分割契約承認株主総会	本件会社分割は会社法第784条第3項の規定による簡易吸収分割であるため、当社は分割契約承認株主総会を開催いたしません。
分割期日（効力発生日）	平成19年10月1日

(2) 分割方式

当社を吸収分割会社とし、田中電子工業を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割です。

(3) 割当株式数

田中電子工業は、本件会社分割に際して、普通株式 23,000 株を当社に対して割当て交付します。

(4) 割当株式数の算定の考え方

上記の割当株式数の算定に当たり、当社及び田中電子工業は、第三者機関に対して、本件会社分割により田中電子工業に承継させる権利義務及び田中電子工業の株式の評価の算定を依頼し、各第三者機関は、DCF 方式等により算定した分析結果を総合的に勘案し、当社と田中電子工業において協議の上で最終的な評価額を決定いたしました。上記の割当株式数は、本件会社分割により田中電子工業に承継させる権利義務の評価額を田中電子工業の株式の評価額で除すことにより算定しました。

(5) 分割により減少する資本金等

本件会社分割により減少する資本金等はありません

(6) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債発行に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(7) 承継会社が承継する権利義務

- ・ MMC エレクトロニクス杭州社に対する持分
- ・ TANAKA ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BH. に対する持分
- ・ 金線事業に関する特許権、技術情報
- ・ 金線事業に属する製品販売に係る売買契約（代理店との間の契約を含む）およびその付随契約の契約上の地位
- ・ MMC エレクトロニクス杭州社との契約の契約上の地位

(8) 債務履行の見込み

本件会社分割後において、当社は債務の履行の見込みはありと判断しております。

なお、本件会社分割により当社が田中電子工業に承継させる債務はありません。

3. 分割当事会社の概要

(1) 商 号	三菱マテリアル株式会社 (分割会社)	田中電子工業株式会社 (承継会社)
(2) 事 業 内 容	セメント及びセメント二次製品の製造・販売、銅・金・銀等の製錬・加工・販売、超硬工具・高性能材料等の製造・販売、電子材料・電子デバイス製品・多結晶シリコン等の製造・販売	半導体用ボンディング材料の製造及び販売
(3) 設 立 年 月 日	昭和 25 年 4 月 1 日	昭和 36 年 6 月 8 日
(4) 本 店 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号	東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 井手 明彦	取締役社長 笠原 康志
(6) 資 本 金	119,457 百万円 (単体)	1,880 百万円 (単体)
(7) 発 行 済 株 式 総 数	1,252,092,486 株 (単体)	380,000 株 (単体)
(8) 純 資 産	481,970 百万円 (連結)	38,641 百万円 (連結)
(9) 総 資 産	1,773,899 百万円 (連結)	21,685 百万円 (連結)
(10) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 6.3% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 6.0% (株)三菱東京 UFJ 銀行 2.9% 明治安田生命保険(相) 2.3% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口 4) 2.3% 三菱 UFJ 信託銀行(株) 1.2% カイハツ産業(株) 1.1% 日本生命保険(相) 1.0% 三菱重工業(株) 1.0% 三菱地所(株) 0.9%	田中貴金属工業(株) 100%

4. 分割する事業部門の内容

(1) 金線事業部門の内容

半導体ボンディング用金線の開発、製造及び販売

(2) 金線事業部門の平成 19 年 3 月期における経営成績

	金線事業部門(a)	当社 19 年 3 月期実績(b)	比 率 (a / b)
売 上 高	19,142 百万円	1,452,108 百万円	1.3%

(3) 承継させる資産、負債の項目および金額（平成 19 年 3 月 31 日現在）（百万円）

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
MMC エレクトロニクス杭州社持分	268.2	なし	
TANAKA ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BH. 持分	88.1		
金線事業に関する特許権、技術情報	0		
合 計	356.3	合 計	0

5. 分割後の当社の状況

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期に変更はありません。また、本件会社分割による当社の業績への影響は軽微です。

以 上